

双面对准单面曝光的操作程序

1. 刷卡开机，开启真空泵、电脑和设备电源。
2. 先将版真空吸附到板架上，下翻板架，使版压在承片台，调节 CCD1 和 CCD2，通过液晶屏看清版上的两个标记线。
3. 操作鼠标，点击“开始对准”，专用计算机记忆下刚才 CCD1 和 CCD2 观察到的版的图形，并显示到液晶屏上。
4. 上下翻转板架，你会发现液晶屏上下翻动后，版的图形和计算机记忆图形重合精度很高，一般应 $\leq \pm 1.5\mu\text{m}$ 。
5. 将需要曝光的片，真空吸附到承片台上，此时片的下平面早已在这次光刻的前刻上了需要对准的标记线，调节承片台 X、Y、 θ 手轮，通过液晶屏上观察到的片上标记线的移动来对准计算机记忆的版的标记线，直到版、片两组标记线重合为止。
6. 按真空密着开关，使版片接触更佳，通过液晶屏观察，确定版片不因“真空密着”而产生漂移，才能进行下一步。
7. 转动曝光头，使曝光头对准承片台。
8. 设定好曝光时间，按“曝光”按钮，快门打开，直到设定好的时间到，快门关闭。基片的上平面完成曝光工作。
9. 转开曝光头，使板架上翻，取下已曝光的基片，换上未曝光的基片。
10. 重复上面动作，完成第二片、第三片、第……的套刻、对准、曝光工作。
11. 结束后关闭设备电源、电脑和真空泵，刷卡下机。